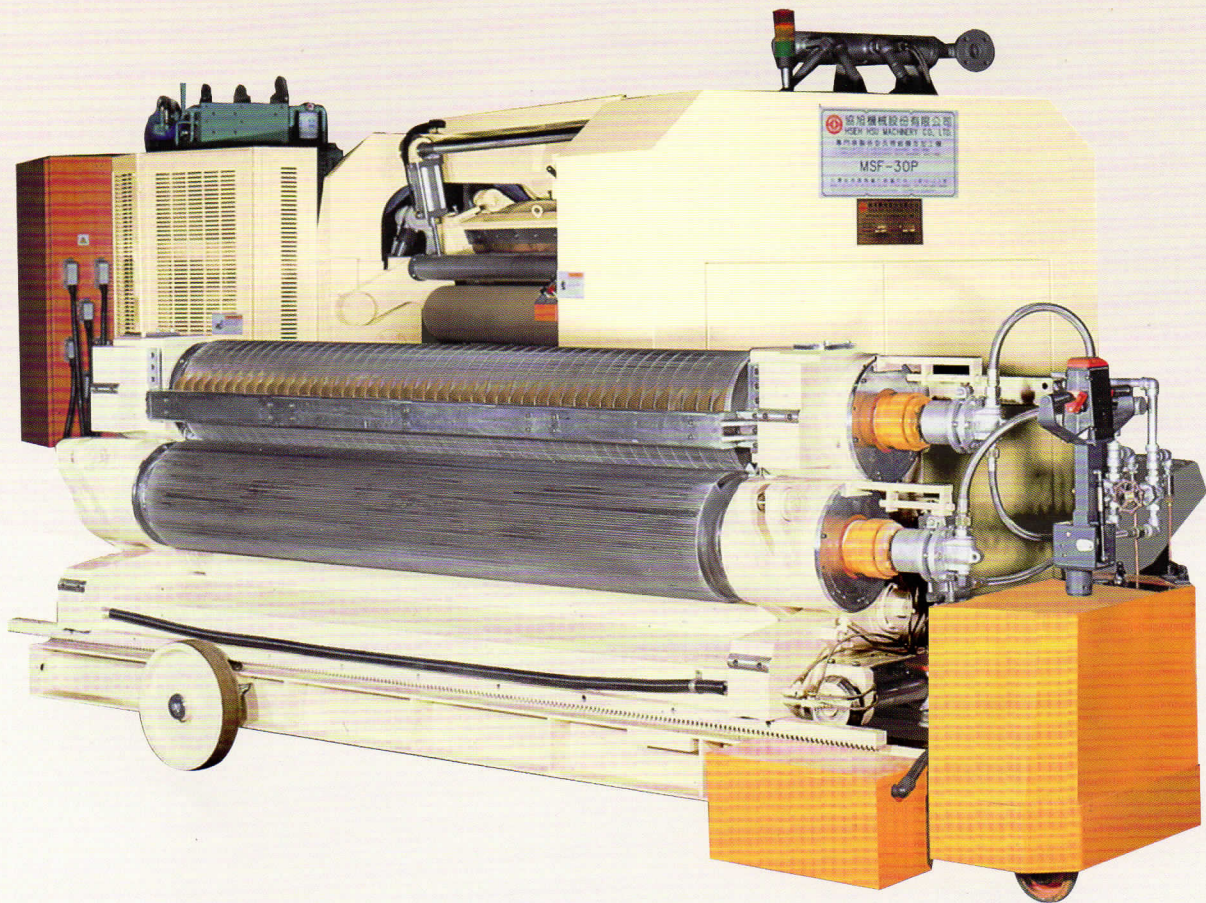


# MSF-30P

## Multi-Cassette Positive Pressure Single Facer

### 正壓卡匣式單瓦楞機



- 全新設計觀念而發展的新機型MSF-30P，無論在機械設計、結構、性能及操作方面皆極為卓越！
- 瓦楞軋置於壓力軋之下方的設計，儘可能降低機器重心之理念，使機器於運轉中之噪音較低，減少了機器的振動，使機器運轉時更順暢、穩定！因瓦楞軋位置降低，使卡匣換軋更為安全、方便、快速。
- 瓦楞軋、壓力軋之潤滑系統，採用耐高溫油脂，可避免因循環式潤滑油易產生漏油或碳化現象而造成培林損壞。
- 瓦楞軋、壓力軋及糊軋等採用油壓系統與蓄壓器控制，具備了油壓控制之穩定性及氣壓控制之緩衝效果。各軋之間隙調整因採用油壓馬達控制，可解決A.C.馬達因潮濕、高溫及振動因素所造成損壞的困擾。
- 採用正壓式設計，使蕊紙能均勻受壓並貼附於瓦楞軋表面，而完美成形。因為均勻之壓力，使瓦楞頂端能均勻地上漿糊，使單瓦楞紙貼合情況更好！
- 輔助預熱壓軋之設計，可適用於不同紙質與生產速度，可減少因壓軋過大之壓力或使用較薄之紙張而造成壓痕，因為輔助預熱壓軋之設計可減少壓痕產生，使單瓦楞紙強度更好！
- 快速換軋，15分鐘，更換瓦楞軋時以電動台車運載，將整組瓦楞軋組成之卡匣配合氣動泵，將整組卡匣送入機器內，並以油壓系統將其卡緊，固定於機器底座上，不須太多工具，僅以幾個按鈕開關即可快速又輕鬆完成瓦楞軋之更換！
- 我們將瓦楞軋所用之蒸汽入口及出口集中在一連接板上，並以氣動閥控制蒸汽之開及關（ON/OFF），瓦楞軋於更換前即可先行預熱，因此於更換完成後不須待機，藉由氣動閥打開蒸汽入口，即可馬上生產。
- 改良式上糊系統，使糊軋及切糊軋涵蓋著整個儲糊空間，而切糊軋更是位於整個糊面底下，使得上糊間隙均勻的分佈。配合糊軋與切糊軋的圓周切線速度差，使得糊軋表面保持穩定的糊模厚度，進而生產出平整的瓦楞紙。
- 依據生產速度及各種紙質的不同，可設定不同之上糊間隙，並可快速確實的自動達到所需的間隙。當車速到達高速後，隔糊寬度能做立即性的補正，以避免漿糊產生擴散情形。遠離熱源的糊槽，可使漿糊免於長時間處於高溫環境而發生糊化現象。加上溢流式的糊盤設計，使得糊面高度保持一定，不因上糊多寡而發生缺糊現象。
- 台車移動式の上糊組合，除清洗方便外，更有利於保養維修工作。
- 簡易操作之控制系統，是MSF-30P之特色之一，觸控式螢幕、配合彩色圖面顯示操作狀態、功能選擇、故障指示、排除及參數設定等皆可表現出此機器功能齊全、操作簡便、人性化。